附件1

深圳市发展和改革委员会2025年第二批

战略性新兴产业专项资金项目申报指南

（半导体与集成电路领域）

本次专项资金扶持涵盖集成电路设计流片、产业化、创新能力建设、国家项目配套四类扶持计划。其中，集成电路设计流片扶持计划包括集成电路流片、国产EDA工具推广应用两大方向；产业化扶持计划聚焦高端芯片产品突破、核心设备及配套零部件突破、关键制造封装材料突破、高端封装测试水平提升、化合物半导体技术水平提升、尖端前沿技术突破等重点领域；创新能力建设扶持计划重点支持建设半导体与集成电路领域产业创新中心、IC设计流片平台、检测认证中心、中试验证平台等产业支撑平台；国家项目配套扶持计划，对承担国家发展改革委集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划及重点研发计划的单位给予配套支持。

一、集成电路设计流片扶持计划

（一）集成电路流片

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第二条。

**2.扶持方向**

支持多项目晶圆（MPW）流片、全掩模工程产品流片。

**3.扶持方式及资助金额**

（1）对于参与晶圆制造厂多项目晶圆（MPW）流片的企业、高校和科研院所，通过专家评审后，按照流片直接费用的30%给予资助，同一单位年度总资助额不超过300万元。

（2）对于首次完成全掩模工程产品流片（包括自组多项目晶圆流片）的企业、高校和科研院所，且工艺制程在28纳米及以下的，通过专家评审后，按照流片直接费用的30%给予资助，同一单位年度总资助额不超过1000万元。

以上项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。流片产品应由申报单位自主研发设计。

（3）实际支出费用计算时间为2025年1月1日以后，以发票日期为准。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）多项目晶圆（MPW）流片、全掩模工程产品流片相关费用支出明细、与相关企业签订的合同、财务凭证、发票等。

（3）多项目晶圆（MPW）流片、全掩模工程产品流片产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与单位其他相关产品的差异说明、已取得集成电路布图设计登记证书或发明专利授权情况等。对于申报全掩模工程产品流片资助的，还需提供该产品为首次流片的证明材料）。

（二）国产EDA工具推广应用

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第三条。

**2.扶持方向**

支持模拟、数字、制造、封测等集成电路EDA工具软件国产化。

**3.扶持方式及资助金额**

（1）对购买国内企业研发的EDA工具并开展28纳米及以下芯片研发制造的企业，通过专家评审后，按照购买该EDA工具实际发生费用的20%给予一次性资助，单个企业年度资助金额不超过200万元。

（2）对购买国内企业研发的EDA工具并开展14纳米及以下芯片研发制造的企业，通过专家评审后，按照购买该EDA工具实际发生费用的30%给予一次性资助，单个企业年度资助金额不超过300万元。

（3）对购买国内企业研发的EDA工具并开展7纳米及以下芯片研发制造的企业，通过专家评审后，按照购买该EDA工具实际发生费用的50%给予一次性资助，单个企业年度资助金额不超过500万元。

以上项目采取事后一次性资助方式。对于同时申报两项及以上不同制程EDA工具资助的企业，年度资助金额上限可累加。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）所购EDA工具应当用于有关芯片设计或制造，EDA工具购置时间在2024年1月1日以后，且流片时间在2025年1月1日以后，以交割单为准。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）项目流片的检测报告。

（3）国内企业研发的EDA工具有关证明材料。

（4）EDA工具购置明细、采购合同、财务凭证、发票等。

二、产业化扶持计划

（一）高端芯片产品突破

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第一条。

**2.扶持方向**

（1）面向AI大模型场景需求，支持突破数据中心CPU、GPU、DSP、FPGA、ASIC等专用芯片，400G以上带宽DPU、100G以上激光器芯片、新型光电融合芯片等互联芯片，以及高性能高能效存储芯片。

（2）面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。

（3）面向新能源汽车万亿级市场，支持14纳米及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的国产替代。

**3.扶持方式及资助金额**

（1）对购买IP开展28纳米及以下制程高端芯片研发的企业，通过专家评审后，按照IP购买实际支付费用的20%给予资助，单一企业年度资助金额不超过300万元。

（2）对购买IP开展14纳米及以下制程高端芯片研发的企业，通过专家评审后，按照IP购买实际支付费用的30%给予资助，单一企业年度资助金额不超过500万元。

（3）支持企业开展AEC-Q系列可靠性标准认证、ISO 26262功能安全管理体系认证、AQG 324车规级半导体模块认证、ISO/TS 16949体系认证等车规级认证，对取得相关认证资质的企业，通过专家评审后，按照认证实际发生费用的50%给予资助，单一企业年度资助金额不超过100万元。

以上项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）实际支出费用计算时间为2025年1月1日以后，以发票日期为准。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）对于申请IP购买资助的，还需提供IP所应用芯片产品详细项目报告，说明IP在该芯片中的应用价值、应用方式及该芯片产品的技术先进性；IP购置明细、采购合同、财务凭证、发票等相关材料。

（3）对于申请有关资质认证资助的，还需提供公司/产品取得相关认证资质的证明材料；开展认证的合同、发票等相关材料。

（二）核心设备及配套零部件突破

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第四条。

**2.扶持方向**

支持开展刻蚀、薄膜沉积、量测检测等核心设备及配套零部件技术研发。

**3.扶持方式及资助金额**

（1）对于我市集成电路产线、中试线、实验线为国产设备提供验证服务的，通过专家评审后，按照验证服务费用的30%给予产线、中试线、实验线所属单位资助，最高不超过200万元。若集成电路产线、中试线、实验线为同一研制单位的同一型号设备提供多次验证服务的，仅对其首次验证服务给予资助。

（2）对于核心设备及零部件首次投入产线使用的设备研制单位，通过专家评审后，按经评审核定的产品研发投入（仅包括用于研发的设备、材料、人力资源投入）的30%给予研制单位资助，单一型号设备及零部件最高不超过1000万元，同一研制单位最高不超过3000万元。

以上项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）为国产设备提供验证服务的集成电路产线、中试线、实验线，验证服务费用的收取日期需在2025年1月1日及以后，具体以银行收款日期为准；核心设备及零部件首次投入产线使用的日期需在2025年1月1日及以后。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）对于为国产设备提供验证服务的集成电路产线、中试线、实验线所属单位，还需提供已验证的产品名称（型号）、国产设备研制单位、功能、主要技术指标等信息；验证服务合同、银行收款凭证等相关材料；用于证明验证服务内容、过程和结果的验证报告；国产设备的相关证明材料，如设备的技术说明书、知识产权证明等。

（3）对于研制核心设备及零部件并首次投入产线使用的单位，需提供核心设备及零部件的知识产权证明等；半导体与集成电路制造企业出具的设备及零部件首次投入产线使用的证明材料，包括使用时间、使用情况、使用效果等。

（三）关键制造封装材料突破

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第五条。

**2.扶持方向**

支持开展14纳米及以下先进制程光刻胶、研磨液、掩膜版等制造材料，临时键合胶、聚酰亚胺、底部填充胶、封装基板等先进封装材料的技术研发。

**3.扶持方式及资助金额**

对于我市集成电路产线、中试线、实验线为国产关键制造及封装材料提供验证服务的，按照验证服务费用的30%给予产线、中试线、实验线所属单位资助，最高不超过100万元。若集成电路产线、中试线、实验线为同一研制单位的同一型号材料提供多次验证服务的，仅对其首次验证服务给予资助。

该项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）为国产关键制造及封装材料提供验证服务的，验证服务费用的收取日期需在2025年1月1日及以后，具体以银行收款日期为准。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）已验证的材料名称、型号规格、研制单位、主要技术指标、验证情况等信息；验证服务合同、银行收款凭证等相关材料；用于证明验证服务内容、过程和结果的验证报告；国产关键制造及封装材料相关证明材料，如材料的技术说明书、知识产权证明等。

（四）高端封装测试水平提升

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第六条。

**2.扶持方向**

支持凸块（Bump）、倒装（Flip Chip）、晶圆级封装（WLP）、重布线（RDL）、芯粒（Chiplet）、硅通孔（TSV）、玻璃通孔（TGV）、2.5D封装、3D封装、混合键合、背面供电、扇出面板级封装（FOPLP）、光电共封装（CPO）等一系列先进封装技术及配套关键材料的研发和产业化。

**3.扶持方式及资助金额**

对于申报先进封装技术研发和产业化的项目，专家评审综合评分60分以上的进入现场核查阶段，通过专家评审、现场核查后，市发展改革委予以批复立项。项目单位须先自行投入资金组织实施项目，待项目通过验收后，按经审计核定的项目实际研发投入（仅包括用于研发的设备、材料、人力资源投入）的30%给予资助，单个项目不超过1000万元。该项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

**5.申报材料**

资金申请报告。

（五）化合物半导体技术水平提升

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第七条。

**2.扶持方向**

支持化合物半导体芯片、器件、装备及材料的推广应用。

**3.扶持方式及资助金额**

对销售自研化合物半导体芯片、器件、装备及材料且相关产品年营业收入首次超过1亿元的企业，通过专家评审后，按照企业当年研发投入（仅包括用于研发的设备、材料、人力资源投入）的30%给予资助，单个企业最高不超过1000万元。该项目采取事后一次性资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）相关自研产品年营业收入首次超过1亿元的统计年份为2024年。

**5.申报材料**

（1）资金申请报告。

（2）由第三方会计师事务所出具的相关自研产品营收年度财务审计报告。

（3）自研产品销售明细清单及关键销售合同与凭证。

（4）自研产品的知识产权证明。

（六）尖端前沿技术突破

**1.政策依据**

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第九条。

**2.扶持方向**

支持自主研发，突破关键环节“卡脖子”技术或前沿变革性颠覆性技术。

**3.扶持方式及资助金额**

专家评审综合评分60分以上的进入现场核查阶段，通过专家评审、现场核查的项目，市发展改革委予以批复立项。项目单位须先自行投入资金组织实施项目，待项目通过验收后：

（1）对突破关键环节“卡脖子”技术或前沿变革性颠覆性技术的集成电路领域攻关项目，按照项目研发投入（仅包括用于研发的设备、材料、人力资源投入）的30%给予资助，单个项目最高不超过3000万元。该项目采取事后一次性资助方式。

（2）对于集成电路制造、封测、装备、材料等领域自主研发取得突破、带动产业优势资源集聚的重大项目，按照项目固定资产投资给予项目单位一定比例的资助，单个项目最高不超过设定金额。该项目采取分阶段资助方式。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

**5.申报材料**

资金申请报告。

三、创新能力建设扶持计划

（一）政策依据

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第八条。

（二）扶持方向

支持建设半导体与集成电路领域产业创新中心、IC设计流片平台、检测认证中心、中试验证平台等产业支撑平台。

（三）扶持方式及资助金额

1.对于成功申报国家产业创新中心的，给予不超过1:1的资金配套，本市配套资金和国家资助资金合计不超过项目总投资的50%，国家专项计划另有规定的，从其规定。项目资助金额按照国家资金拨付进度分阶段拨付。

2.对于建设符合我市产业布局的IC设计流片平台、检测认证中心、中试验证平台等产业支撑平台的项目，专家评审综合评分60分以上的进入现场核查阶段，通过专家评审、现场核查后，市发展改革委予以批复立项。项目单位须先自行投入资金组织实施项目，待项目通过验收后，按经审计核定的平台实际建设投资（不含土建工程部分）的20%给予资助，单个平台累计不超过3000万元。该项目采取事后一次性资助方式。

（四）申报要求

1.须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

2.项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

3.项目单位须具有相应的基础条件，已有技术服务团队总人数不少于50人，其中专职研发或技术服务人员不少于45人，相关研发、检测及技术服务设备原值不少于3亿元，相关技术服务场地面积不少于3000平方米，能为产业关键技术和设备的研究、开发、成果转化等提供支撑和保障。

4.对于申报国家产业创新中心资金配套的，需获得国家发展改革委批复同意立项，且国家产业创新中心的建设期截止日期不早于2025年9月30日。

（五）申报材料

1.资金申请报告。

2.对于申报国家产业创新中心资金配套的项目，需提供国家发展改革委的批复文件。

3.对于建设IC设计流片平台、检测认证中心、中试验证平台的项目，需提供对外开放并用于公共服务的相关证明材料。

四、国家项目配套扶持计划

（一）政策依据

《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（深发改规〔2025〕9号）第十条。

（二）扶持方向

支持有关单位承担国家发展改革委开展的半导体与集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划。

（三）扶持方式及资助金额

对于承担国家发展改革委开展的集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划的单位，给予不超过1:1的资金配套，本市配套资金和国家资助资金合计不超过项目总投资的50%，国家专项计划另有规定的，从其规定。项目资助金额按照国家资金拨付进度分阶段拨付。

（四）申报要求

1.须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

2.项目单位应拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

3.申报项目已获得国家发展改革委批复同意立项，且项目的建设期截止日期不早于2025年9月30日。

（五）申报材料

1.资金申请报告。

2.国家发展改革委的批复文件。

附件1-1

**深圳市发展和改革委员会战略性**

**新兴产业专项资金项目**

**资金申请报告**

**项 目 名 称：**

**领 域 方 向：**

**申 报 单 位：**

**项目负责人：**

**联 系 方 式：**

二〇 年 月

资金申请报告编制大纲

（可根据项目实际情况适当增减相关内容）

一、项目摘要（1500字以内）

包括项目名称、项目单位概况、建设方案（建设内容、技术路线、投资规模、建设周期与建设地点）、项目总投资及资金来源，项目建设条件落实情况（已有技术基础，资金、设备、人员落实情况），项目主要目标及指标、结论与建议。

二、项目单位基本情况

包括项目法人所有制性质、主要股东与法人代表情况、组织管理架构、发展战略与规划、所处产业链环节与行业地位；主营业务、主要产品或服务及市场表现、近三年经营业绩（总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、利税情况、研发投入、资产负债率等）；已获得的各项资质、认证及近年来主要（科研）成果、主要设备列表及原值等。成立时间不足三年的项目单位提供单位成立以来的相关概况。

三、项目建设必要性

（依据、背景与意义）包括国内外相关产业现状及趋势预测，所属产业链关键环节和难点，项目建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。

四、技术发展与应用前景分析

包括项目技术先进性与成熟度，主流技术路线对比，项目产品与国内外主要竞品对比，关键技术难点与突破点，产品未来市场需求及前景等。

五、项目的技术基础

包括研发团队情况，成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，主要技术或工艺特点，技术路线发展比较（包括本单位相关技术水平优势和劣势、关键技术突破点），该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

六、项目建设任务与目标

包括项目的发展战略与思路、主要发展方向、拟突破的关键技术点、总体发展目标、项目指标等。项目指标分为约束性指标和预期性指标，其中约束性指标需针对项目中期核查及验收环节分别提出清晰、可量化、可考核的具体指标，可包括技术参数、成果转化、取得资质、人才培养、知识产权等；预期性指标主要指通过项目建设预计可带来的经济及社会效益，包括形成营收、利润、订单、产业链带动作用等，仅需针对验收环节提出。

七、项目建设方案

包括具体建设内容、项目实施面积和地点、团队配置方案（项目负责人及核心人员提供资历简介）、技术方案、设备方案、工程方案，项目建设管理机制等。项目实施进度包括实施周期和进度安排、每个周期的主要任务和项目指标等。

八、投资估算及资金筹措

包括项目总投资估算表、建设投资估算、分年投资计划表、项目资金筹措及落实情况和申请市政府补贴资金使用方案。

项目投资构成主要包括建设投资、研发费用和铺底流动资金，项目实际投资构成应符合对应的申报指南要求。其中：

（一）建设投资主要包括建筑工程费、安装工程费、场地改造费、设备及工器具购置费（含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁及合同约定的其他建设投资费用）等；

（二）研发费用包括自主研发费和委托开发费。其中，自主研发费主要包括科研材料及事务费（含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费）、人力资源费（含研发人员工资、劳务费、专家咨询费）、其他费用（含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等）。委托开发费主要是指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。

（三）铺底流动资金主要包括燃料动力费、生产原材料费、场地租赁费、基本预备费、项目执行期利息等。

项目资金筹措方案中，自有资金（不包括银行贷款）不低于项目总投资的30%，且须提供银行出具的证明文件。资金使用方案需列出项目建设所需购置的主要设备、技术及软件等清单（设备种类、数量、参考单价、是否已购、是否采用财政直接补贴资金等）以及研发、土建、流动资金等。

九、项目经济及社会效益分析

项目建成后的运营方案、管理模式、经济和社会效益分析。

十、节能及环境影响

包括节能及环境影响评价等，其中节能专篇章节需按照《[固定资产投资项目节能审查办法](http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2010ling/W020100921572054070349.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank)》要求进行编写。

十一、项目风险分析

包括项目的技术风险、市场风险、资金风险等评价情况，以及风险控制思路等。

十二、其它需说明的问题

附件1-2

资金申请报告附件清单

附件目录

1.项目基本情况说明（见附件1-2-1）。

2.项目申报与建设管理承诺函和财政支持发展专项资金使用（资助）廉洁承诺书（附件1-2-2）。

3.项目单位法人注册文件、组织机构代码证。

4.银行出具（自申报截止日期前三个月内）的自有资金存款证明文件（扫描件1份），银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同（若有贷款）。

5.项目单位近三年财务审计报告。若项目单位成立时间不足三年，需提供单位成立至今的财务审计报告。财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台备案。申请单位为事业单位的，可提供财务报表。

6.项目单位近三年研发经费实际支出专项审计报告。若项目单位成立时间不足三年，需提供单位成立至今的研发经费实际支出专项审计报告。专项审计报告需在注册会计师行业统一监管平台备案。申请单位为事业单位的，可提供财务报表。

7.项目相关的技术先进性证明及奖励文件，包括产学研合作或科技成果转化典型案例、查新报告、软件著作权、发明专利、产品检测报告等，如无法提供需提交情况说明。

8.申报项目团队成员清单（需标明专职研发人员）及相关证明材料，包括学历学位证明或职称证书（二选一）、社保缴纳证明，团队成员清单中所列人员需全部提供等。

9.项目用地规划许可文件及土地使用权属证明，租赁场地的请提供租赁证明，土地权属证明文件的所有人或租赁合同的承租方应与申报单位一致。

10.涉及环境影响、节能审查的，应分别提供生态环境部门出具的环境影响评价文件的批复文件、发展改革部门出具的固定资产投资项目节能审查意见。环境影响评价、节能审查文件项目名称须与申报项目名称一致。如项目不属于环境影响、节能审查范围的，项目单位须出具不影响环境、不涉及节能审查的承诺函。环评目录可前往我市生态环境部门网站查询（https://meeb.sz.gov.cn/xxgk/qt/hbyw/hjyxpj/content/post\_8389508.html，适用于未完成区域空间生态环境评价区域；https://meeb.sz.gov.cn/xxgk/qt/hbyw/hjyxpj/content/post\_9561232.html，适用于已完成区域空间生态环境评价区域）。节能审查详询各区发展改革部门。

11.必要的生产、经营许可及认证文件，若无法提供需提交情况说明。

附件1-2-1

项目基本情况说明

深圳市发展和改革委员会：

我单位于XX年XX月XX日申报2025年战略性新兴产业项目，项目名称为XXXXXX，现将项目基本情况说明如下：

项目计划总投资XXXXX万元，截至项目申报时点（20XX年X月X日），已完成投资XXXX万元，计划新增投资XX万元（详见附件1-2-1.1至1-2-1.4）。

XX（单位名称）

20XX年X月X日

附件1-2-1.1

项目基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **项目名称** |  |
| **申报时间** | 20XX年X月X日 |
| **申报扶持计划类别** | *（示例：创新能力建设扶持计划）* |
| **建设地点** |  |
| **建设期** | 20XX年X月X日-20XX年X月X日 |
| **成立时间** |  | **注册资本** |  |
| **前五位股东情况** | **股东名称** | **持股比例** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **近3年财务经营情况****（万元）** |  | 20XX年 | 20XX年 | 20XX年 |
| 总资产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  |  |
| 销售收入 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| **主要资质和获奖情况** | （不超过5项） |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **项目前期基础情况** | （包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等，不超过500字） |
| **建设或应用示范目标** | （不超过200字） |
| **主要建设内容** | （包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过1000字） |
| **项目总投资****（万元）** | **建设投资** | **研发费用** | **铺底流动资金** |
|  |  |  |
| **资金筹措方案** | 包括自筹、贷款 |

附件1-2-1.2

项目总投资明细表

|  |
| --- |
|  **（单位：万元）** |
| **项目单位** |  |
| **项目名称** |  |
| **申报时间** | 20XX年X月X日 |
| **申报扶持计划类型** | *（示例：创新能力建设扶持计划）* |
| **投资明细** | **已完成投资** | **新增投资** | **小计** |
| **1.建设投资** |  |  |  |
| 建筑工程费 |  |  |  |
| 安装工程费 |  |  |  |
| 场地改造费 |  |  |  |
| 设备及工器具购置费 |  |  |  |
| **2.研发费用** |  |  |  |
| 科研材料及事务费 |  |  |  |
| 人力资源费 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |
| 委托开发费 |  |  |  |
| **3.铺底流动资金** |  |  |  |
| 燃料动力费 |  |  |  |
| 生产原材料费 |  |  |  |
| 场地租赁费 |  |  |  |
| 基本预备费 |  |  |  |
| 项目执行期利息 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

备注：

**1.设备及工器具购置费，**含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁及合同约定的其他建设投资费用。

**2.科研材料及事务费，**含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费。

**3.人力资源费，**含研发人员工资、劳务费、专家咨询费。

**4.其他费用，**含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等。

**5.委托开发费，**指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。

附件1-2-1.3

项目已购置设备/软件购置清单

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **参考数量** | **参考单价** | **小计** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | —— |  | —— |  |

备注：

1.项目已购置设备/软件是指自**项目建设之日起**至**项目申报之日**已购置的设备/软件；

2.本表格设备须按照设备参考单价从高到低顺序依次排序。

附件1-2-1.4

项目拟新增设备/软件购置清单

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **参考数量** | **参考单价** | **小计** | **是否使用财政资助资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | —— |  | —— |  | —— |

备注：

1.项目拟新增设备/软件是指自**项目申报之日**至**项目建设期结束**计划新增设备/软件；

2.本表格设备须按照设备参考单价从高到低顺序依次排序。

附件1-2-2.1

项目申报与建设管理承诺函

深圳市发展和改革委员会：

我单位 项目，已明确规划建设，为保证项目如期建成和有效运行，就项目申报与建设管理承诺如下：

1.我单位对项目申请报告内容和附属文件等申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。

2.此前我单位承担建设的已获市级政府资金补助项目与本次申报项目建设内容和项目投资等方面无任何重复。

3.本项目建设内容和运营目标确保与资金申请报告的建设内容和目标一致，并确保资金已落实到位。

4.本项目建设场地已落实。建设地址位于 ，建筑面积 平方米。

5.本项目建设和运营将建立长期运营管理制度和考核体系， 为项目负责人，身份证号 ，联系电话 ； 为项目申报人，身份证号 ，联系电话 ； 为项目答辩人，身份证号 ，联系电话 。以上人员均为我单位正式员工，社保缴纳记录详见团队成员证明材料。

6.我单位开发的知识产权明晰完整，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业机密。

7.我单位未违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，未被列入严重失信主体名单，提供**国家、省、市信用网站下载**的信用报告详见附件。

8.若发生与上述承诺相违背的事实，由我单位承担全部法律责任。

附件：信用报告

项目联系人1： 项目联系人2：

项目管理部门负责人： 项目业务部门负责人：

所在部门： 所在部门：

手机： 手机：

邮箱： 邮箱：

特此承诺。

项目单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期:

附件1-2-2.2

财政支持发展专项资金使用廉洁承诺书

本单位郑重承诺：

本单位法定代表人、董事、主要股东、实际控制人及工作人员严格遵守法律法规，在专项资金申领过程中，不以申领为目的向公职人员提供不正当利益，实施贿赂行为；不为争取本单位利益或个人利益说情打招呼；不进行虚假项目申报；不利用有偿中介组织违规申报项目；不以申领为目的聘用公职人员配偶、子女及其配偶等亲属在企业中担任职务或接受利润分成；不以申领为目的为公职人员提供借贷款或车辆和房屋使用让与；不以申领为目的与公职人员开展不正当的社会交往等。

本单位将严格遵守专项资金申领各项程序规定，如实提供申领材料，按要求开展项目建设，自觉接受项目评审和检查，不断提升申领资金的使用效益。如今后涉及公职人员违法违纪案件，自愿接受从严从重惩戒。

法定代表人签名：

 承诺日期：

（单位盖章）